

Pressa A Caldo Automatica Sottovuoto Da 15 Tonnellate Con Piastre Riscaldate 200X200Mm E Raffreddamento Ad Acqua

Numero articolo: XP33



introduzione

Scopri la pressa a caldo automatica da 15 tonnellate di KINTEK: piastre riscaldate 200x200mm (fino a 500°C), controllo PID preciso, raffreddamento ad acqua e camera in SUS 304 per la lavorazione sottovuoto o con gas inerte—ideale per celle a busta per batterie, laminazione di polimeri e saldatura per diffusione.

Ulteriori informazioni

Applicazione	Descrizione	Vantaggio chiave
Laminazione celle a busta per batterie	La laminazione di celle a busta per batterie agli ioni di litio o allo stato solido richiede pressione e calore uniformi per legare gli strati senza danneggiare l'elettrolita. La capacità del vuoto rimuove l'umidità e i gas, prevenendo la delaminazione e migliorando la longevità della cella.	Elimina la delaminazione, migliora la conduttività ionica e prolunga la vita del ciclo.
Laminazione film in polimero	Lamina fogli di polimero o film compositi per l'incapsulamento elettronico, l'imballaggio medico o display flessibili sotto temperatura e pressione controllata.	Produce legami senza bolle e ad alta chiarezza con controllo preciso dello spessore.
Saldatura per diffusione	Unisce metalli, leghe o ceramiche a temperature elevate sotto alto vuoto senza fusione, creando legami per diffusione atomica.	Raggiunge interfacce ad alta resistenza e senza pori, ideali per scambiatori di calore e dispositivi microfluidici.
Compattazione e sinterizzazione in polvere	Comprime polveri metalliche o ceramiche in una matrice sotto vuoto e calore per formare pellet o preforme densi.	Migliora la densità, riduce la porosità e migliora le proprietà meccaniche ed elettriche.
Indurimento materiali compositi	Indurisce compositi avanzati rinforzati con fibre con profili di pressione e temperatura precisi in atmosfera inerte.	Ottimizza il reticolazione, previene l'ossidazione e assicura laminati senza vuoti.
Assemblaggio elettronica flessibile	Lamina e incapsula circuiti flessibili, display OLED o sensori a film sottile con adesivi attivati dal calore sotto vuoto.	Mantiene l'allineamento, elimina i difetti di degassamento e protegge i componenti sensibili.

Specifiche	Valore / Dettagli
Modello	XP33
Pressione di lavoro massima	≤ 15 Tonnellate (150 kN)
Temperatura di lavoro della piastra	Temperatura ambiente - 500 °C, touchscreen PID programmabile
Potenza di riscaldamento	3000 W
Dimensioni della piastra	200 mm × 200 mm
Apertura piastra (Giorno)	50 mm
Pompa per vuoto inclusa	Pompa per vuoto a palette rotante (standard)
Livello di vuoto (Relativo)	< -0,1 MPa
Materiale della camera	Acciaio inossidabile SUS 304

Specifiche	Valore / Dettagli
Compatibilità gas atmosferici	Azoto (N ₂) / Argon (Ar)
Metodo di raffreddamento	Raffreddamento ad acqua circolante (entrambe le piastre)
Dimensioni esterne	650 × 492 × 725 mm
Peso netto	235 kg
Alimentazione	AC 220V / 50Hz, Monofase